



FATC 記憶體最佳代工夥伴



福懋科技 2021年法人說明會

執行副總經理暨發言人 張憲正

2021年11月25日



免責聲明

簡報內容（含本會議中所揭露之資訊）含有若干預測性資訊，僅供參考之用。福懋科技股份有限公司或任何第三人均不就該預測性資訊之正確性與完整性承擔任何責任，亦不負更新或更正該資訊之義務，請您務必謹慎審閱以上資訊。如未經許可，亦請您切勿散播、重製或揭露以上資訊之一部分或全部予第三人。



會議議程

1

2021年前三季營運績效及財務狀況

2

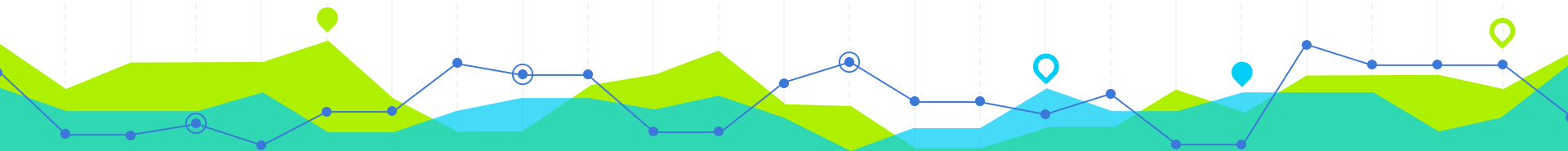
研究發展規劃

3

營運重點與市場展望

4

問與答



2021 年前三季 營運績效及財務狀況

1



2021年前三季財務摘要

單位:新台幣仟元

項目 會計科目	2021年Q1~Q3		2020年Q1~Q3		差異	
	金額	%	金額	%	金額	%
營業收入	7,449,895	100.0	7,342,406	100.0	107,489	1.5
營業毛利	1,494,618	20.1	1,393,650	19.0	100,968	7.2
營業利益	1,335,559	17.9	1,243,222	16.9	92,337	7.4
稅前息前折舊攤銷前利益	2,492,576	33.5	2,565,570	34.9	-72,994	-2.8
稅前淨利	1,394,811	18.7	1,307,733	17.8	87,078	6.7
本期淨利	1,133,452	15.2	1,086,685	14.8	46,767	4.3
每股盈餘(元/股)	2.56		2.46		0.10	
每股淨值(元/股)	26.88		24.64		2.24	



2021年各季綜合損益比較表

單位:新台幣仟元

項目	2021年Q3		2021年Q2		2021年Q1	
	金額	%	金額	%	金額	%
會計科目						
營業收入	2,448,632	100.0	2,466,909	100.0	2,534,354	100.0
營業毛利	476,070	19.4	518,117	21.0	500,431	19.7
營業利益	420,947	17.2	465,456	18.9	449,156	17.7
稅前息前折舊攤銷前利益	856,428	35.0	810,190	32.8	825,958	32.6
稅前淨利	498,594	20.4	444,671	18.0	451,546	17.8
本期淨利	413,701	16.9	358,515	14.5	361,236	14.3
每股盈餘(元/股)	0.94		0.80		0.82	
每股淨值(元/股)	26.88		26.16		27.83	



2021年第3季與第2季差異說明

單位:新台幣仟元

項目 會計科目	2021年Q3		2021年Q2		差異		差異說明
	金額	%	金額	%	金額	%	
營業收入	2,448,632	100.0	2,466,909	100.0	-18,277	-0.7	營收季減0.7%，主要係銷售量增加6.55%及平均代工單價減少6.92%所致。
營業毛利	476,070	19.4	518,117	21.0	-42,047	-8.1	2021年Q3毛利季減8.1%，主要係銷售量增加及代工單價減少所致。
營業利益	420,947	17.2	465,456	18.9	-44,509	-9.6	2021年Q3營業利益季減44,509仟元，主要為毛利減少42,047仟元、推銷管理費用增加1,713仟元及研發費用增加749仟元。
本期淨利	413,701	16.9	358,515	14.5	55,186	15.4	本期淨利季增55,186仟元，主要為營業利益減少44,509仟元、兌換盈餘增加48,177仟元、股利收入增加57,808仟元及所得稅費用減少1,263仟元。



現金流量表

2021年累計前三季現金流量

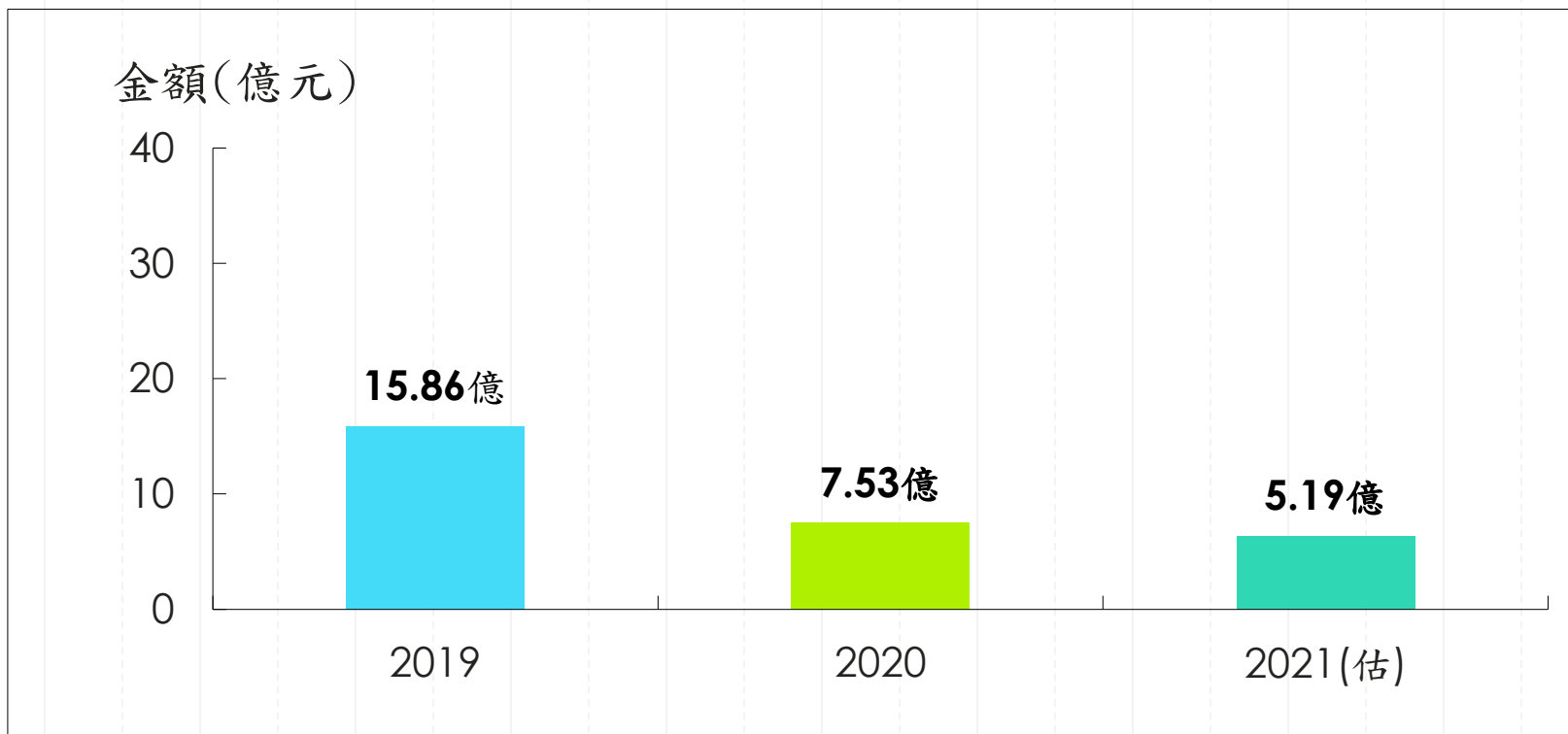
單位:新台幣仟元

	2021年Q3	2021年Q2			
期初餘額	3,205,334	2,579,005	2,171,018	-169,017	-1,017,004
營業活動之現金流量	843,653	694,588	營業活動之現金流量	資本支出	股利支出
資本支出	-50,952	-66,186		-12,233	
其他	-244	-2,073		其他	
股利支出	-1,017,004	0			
期末餘額	2,980,787	3,205,334	2,008,023		
自由現金流量	792,701	628,402	2021/1/1 期初餘額		2,980,787
					2021/9/30 期末餘額

2021年前三季自由現金流量為2,002,001仟元

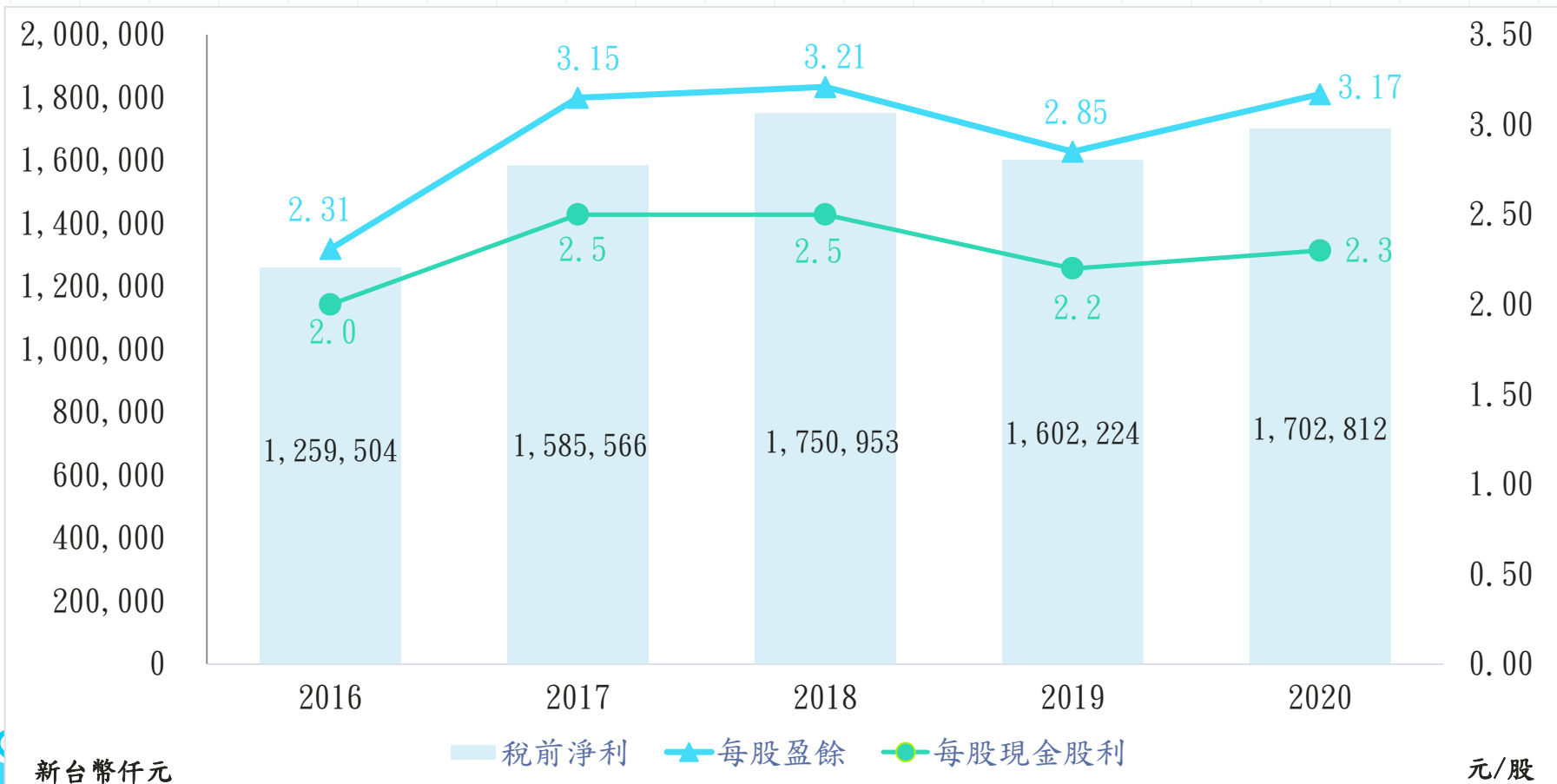


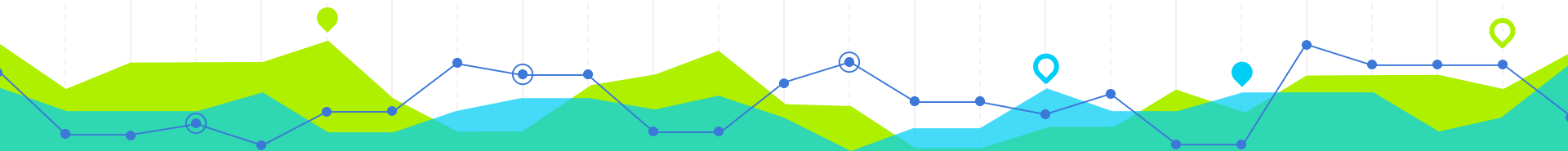
歷年資本支出





近五年之稅前淨利、稅後EPS、現金股利





研究發展規劃

2



研究發展

在5G終端產品人工智慧所需記憶體配合要求發展下，記憶體晶片持續朝高頻寬、高速度、高容量、多功能性與低耗能發展，福懋科技依此趨勢擬訂研發方向如下：

- 1 將不同功能晶片整合並微縮各晶片間訊號連結封裝成多功能單顆IC。
為將載板線路設計成最佳化匹配，應用高速電性模擬驗證與結構應力
- 2 分析及模流特性分析等技術模擬IC特性，來達到封裝後輕、薄、短小及高效能、多功能的目標。
- 3 配合記憶體製程微縮及DDR5產品開發，將發展覆晶封裝高腳數的銅凸塊結構開發、灌膠及微間距接合封裝等技術。
- 4 持續應用與開發既有封測技術，提供客戶在5G所需記憶體的封裝代工需求。



營運重點與市場展望

3



營運重點

- 1** 網路通訊、智慧生活、IoT/AIoT及車用電子等需求成長，帶動利基型記憶體需求，也跟著成長，雖然短期內供應鏈零阻件有部份議題，但短期修正後仍會重回成長軌道。
- 2** 雲端伺服器、筆記型電腦、電競及遊戲機等需求仍持續熱絡，帶動記憶體模組需求同步受惠，將持續追求產量提昇來滿足客戶的需求。
- 3** 佈局新世代DDR5高速、高容量記憶體產品所需之先進封裝、測試、模組之製程及技術。



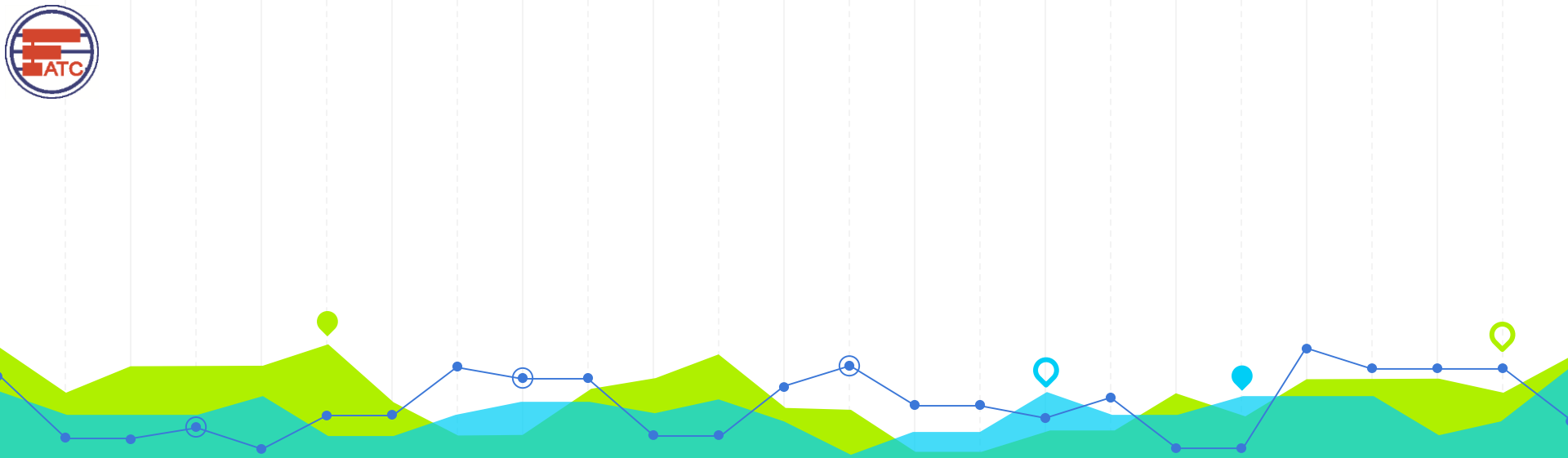
營運回顧與展望

1 2021年第三季持續穩定成長。

2 第四季市場短暫修正。

3 遠距應用、物聯網、汽車智能化及電動化及高速運算等潮流，預期將成為記憶體產業新的成長動能。產業短期修正仍將重回上升軌道。

4 原料仍處在供不應求狀態，公司已採多項改善措施因應



問與答

4



Thanks !